

2026 年 9 月吉日

御得意様 各位

無料 Web セミナー

AI 時代の半導体を支える表面処理と実装技術 ーなぜ今、「つなぐ技術」が注目されるのかー

拝啓

初秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、9 月 17 日に無料 Web セミナーを開催することとなりました。
開催概要およびご参加方法につきましては、下記をご参照ください。

【開催概要】

AI の普及により、半導体にはこれまで以上に高速性・大容量化が求められています。一方で、性能向上を支えてきた微細化には限界が見え始めています。

その中で注目されているのが、複数のチップを組み合わせる性能を引き出す実装技術です。HBM やチップレットの普及に伴い、半導体業界では競争の中心が「チップをつくる技術」から「チップをつなぐ技術」へと広がりつつあります。

本セミナーでは、AI 時代に実装技術が重要視される背景を解説するとともに、近年注目される中工程や接続構造の技術動向を紹介します。また、それらを支えるめっき・表面処理技術の役割についても分かりやすく解説します。業界動向・実装技術の動向を把握したい方に向けて、AI 時代の半導体ビジネスを牽引する情報をお届けします。

開催日 : 2026 年 9 月 17 日 (木)
時間 : 11:00～(約 50 分) ※日本時間
費用 : 無料
形式 : Web セミナー (Zoom 使用)
講師 : 営業部 日本営業グループ 西日本営業課 下田 隆博

【お申込み方法】

下記リンク先のお申込みフォームよりご登録ください。

<https://www.meltex.com/registration.html>

【お問合せフォーム】

なお、Web セミナーや、その他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。お客様からのお問い合わせには、メールにてご返信いたします。

<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともよろしくお願いいたします。

敬具